

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-C14 鍍金機)		
ISSUE DATE	2021-04-15	REVISION	1.1	PAGE	第 1 / 2 頁

一、目的：

定義鍍金機操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於鍍金機。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過鍍金機考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

無。

六、標準作業程序：

1. MES 控制系統開啟設備
2. POWER：鍍金機電源開關，使用前開啟即可；使用完畢請關閉電源。
3. DISCHARGE CURRENT & VACCUM：真空計和電流計。
4. TIME SETTING：時間設定，單位為秒。REMAIN 顯示設定的反應時間。
5. VOLTAGE & DISCHARGE
6. VOLTAGE 分為 HIGH 為鍍膜模式，LOW 為電漿清潔模式：
7. 電漿清潔：DISCHARGE CURRNET 約為~2 mA，VACCUM 約為 15~20 Pa。
8. 濺鍍模式：DISCHARGE CURRNET 約為 15~18 mA，VACCUM 約為~8 Pa。鍍率約 10 nm/min。
9. 設定好 TIME 及 VOLTAGE MODE 後，按下 DISCHARGE 按鍵即可開始。
10. MAIN VALVE：OPEN 為開啟氣體閥件，抽真空或破除真空皆需要開啟此閥件；CLOSE 關閉氣體閥件用。
11. VACUUM ADJUST：調節反應腔體內部壓力用。當設定好 TIME 及 VOLTAGE MODE，按下 DISCHARGE 後，藉由此旋鈕調整內部壓力，使內部達到符合所執行模式的 VACCUM 及 DISCHARGE CURRENT 環境。

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-C14 鍍金機)		
ISSUE DATE	2021-04-15	REVISION	1.1	PAGE	第 2 / 2 頁

12. 製程結束，請將腔體抽真空。

13. MES 控制系統 關閉設備。

七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
2. Q4-NL03 設備考核表
3. Q4-NL04 設備點檢表
4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單